



ISSM2008 半導体生産技術国際会議 ネットワーキングセッション参加ご案内

名称: ISSM2008 ネットワーキングセッション
併催行事: ISSM2008 (半導体生産技術国際会議)
ISSM 主催: 応用物理学会、IEEE、SEMI
会期: ISSM2008 ネットワーキングセッション
2008年10月27日(月) 午前12:00~20:00 (Keynote Speech の為、13:00-15:00 は除く)
会場: ハイアットリージェンシー東京(新宿) B1F クリスタルルーム

本案内の対象者

本案内は半導体製造に関わる装置・機器・材料・ソフトウェアまたはIPなどを提供するサプライヤーならびに学術関係者の皆様を対象にしています。

ネットワーキングセッションの目的

半導体生産技術の国際会議、ISSM(International Symposium on Semiconductor Manufacturing)では、2006年から「ネットワーキングセッション」と題して、主として、半導体製造装置・材料・設備・ソフトウェアまたはIPなどを提供するサプライヤーならびに学術関係者各位に新たな形態で参加していただく機会として、「ISSM ネットワーキングセッション」を設け、本年ISSM2008の開催が2回目となります。

ISSMは正規の論文投稿と審査に基づく国際会議です。優秀論文は毎年IEEEのTSM(Transaction on Semiconductor Manufacturing)に掲載されます。したがって、ISSMでは商業色の強い論文は排除されます。

しかしながら半導体製造技術は、市販の機器やソフトウェアの利用の上に成り立っています。論文発表で優れた問題解決法が提案された場合、背後には市販の機器やソフトウェアの効果的な適用があります。また、論文発表でブレークスルーが必要なテーマが提示される場合もあり、その問題解決に市販のシステムの適用が有効なケースもあります。

「ISSM ネットワーキングセッション」の狙いは、会議の参加者に対して、サプライヤーの皆様が問題解決に関わる手法やアイデアを提示すると同時に、会議への参加ならびに参加者との交流を通じて、半導体製造の問題点や適切なソリューションを提供するためのきっかけなど見出していただくことにあります。

このような「ネットワーキングセッション」の目的およびメリットをまとめると以下のようになります。

- 1) 半導体製造に関わるソリューションの提示とビジネスの紹介
- 2) 会議参加者との交流を通じて半導体製造に関わる問題点ならびにアプローチの把握
- 3) ビジネス関係構築の機会

ISSM ネットワーキングセッションの概要

ネットワーキングセッションではサプライヤーの皆様が会場に設置されたブース内で自由に製品紹介を行うことができます。概要は以下です。

- 1) 会議の初日(10月27日)昼食時からオープンし、会場はメイン会議場と隣接、レセプション時には会場との壁を取り払い、会議の参加者の皆様をネットワーキングセッションに誘導します。
- 2) ネットワーキングセッションへの申込者は自由に製品説明を行えます。また、同時に行われているポスターセッションに参加することも可能です。

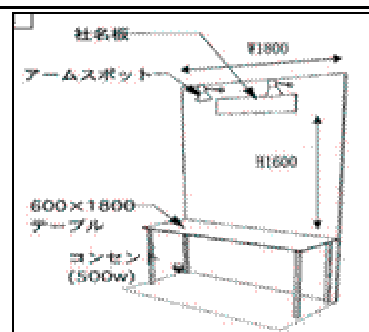
さらに、論文投稿とネットワーキングセッション参加を連携して行うこともできます。たとえば、投稿論文では純粋に技術的側面からの提案を行い、ネットワーキングセッションを通じて、具体的アプローチの紹介を行うなどです。ただし、論文の採択およびネットワーキングセッションへの参加可否はリンクされません。まったく別に独立して審査されます。

ISSM ネットワーキングセッションのブース仕様

主催者側で以下の基礎ブースを準備いたします。

- 1) バックパネル (幅1.8m 高さ2.5m)
- 2) テーブル (奥行き0.6m 幅1.8m)
- 3) コンセント(500W) 1個
- 4) アームスポット 2個
- 5) 社名板 (和英併記)

資料掲示可能スペースは、幅1.5m 高さ1.6mを目安として下さい。





ISSM ネットワーキングセッション参加申し込み概要

- 1) 参加費用 150,000 円 (税込) / 1ブース
- 2) 参加人数および特典
1ブースにつき 2 名様まで、同日 10 月 27 日の ISSM セッションに、一般 36,000 円のところ無料でご参加頂けます。
プロシーディング(予稿集)は一冊とさせていただきます。
- 3) 半導体製造に関わるものであれば、業種や業態ならびに機関などによる参加の制限はありません。
- 4) 最大2ブースとします。
- 5) 申し込み期限: 2008 年 8 月 29 日(金) **(ご好評につき 9 月 26 日(金)まで延長いたしました)**
- 6) お申し込み方法: ISSM Website
<http://www.semiconductorportal.com/Research/showResearch.cfm?id=0000014> よりオンラインにてお申込み下さい。
- 7) ブース位置につきましては、ISSM 論文委員会にて、該当カテゴリー(下記の論文エリアを参照します)などを鑑み決定します。
- 8) 申し込みブースが予定数(40 ブース)を超えた場合は、調整をお願いすることがあります。

解約について

やむなく取り消しをされる場合には文書にてご連絡下さい。この場合、下記のキャンセル料をお願いいたします。

- | | |
|------------------------------|------------|
| 申込書確定通知後 ~ 2008 年 8 月 29 日まで | ブース料の 50% |
| 2008 年 8 月 30 日以降 | ブース料の 100% |

ISSM ネットワーキングセッション参加者の皆様への留意事項

- 1) 約 40 ブース用意する予定です。これを超えて参加申し込みが合った場合には、プログラム委員会にて参加の可否を審査いたします。
- 2) ISSM2008 のホームページの、論文募集要項をよくお読みいただき、できるだけ ISSM のテーマに沿った製品展示ならびにソリューションの提案をお願いいたします。
- 3) ポスターは英語または日英併記です。英文での説明は必須です。
- 3) 製品およびパンフレット等の持込は自由です。
- 4) 2 名様を超える 27 日聴講者、または 3 日間フルに参加される場合は、通常の ISSM 参加登録費用が必要です

今後のスケジュール

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 2008 年 8 月 29 日 出展申込締切 | 9 月 26 日 |
| 2008 年 9 月 30 日 出展料お支払い期限 | 10 月 24 日 |
| 2008 年 10 月 27 日 午前 搬入・セットアップ | |
| 2008 年 10 月 27 日 20:00-21:00 撤去 | |

ISSM とは

ISSM は半導体製造に関する技術を幅広く取り扱う唯一の国際会議です。本年は 10 月 27 日から 29 日まで東京で開催されます。半導体メーカーを中心に内外から毎年 450 名程度の参加者があります。

(詳細は別紙の論文募集要項または <http://www.semiconportal.com/issm/> をご参照ください。)

ISSM2008 がカバーする論文エリア(参照用)

- ・ 工場設計および搬送自動化(FD)
- ・ 製造ラインの戦略及び運営管理(MS)
- ・ 生産管理および制御(MC)
- ・ プロセス制御・モニタリング(PC)
- ・ プロセスおよび材料の最適化(PQ)
- ・ 欠陥低減・歩留まり向上(YE)
- ・ 汚染防止及びウルトラクリーンテクノロジー(UC)
- ・ 環境・安全(ES)
- ・ 製造装置・測定装置(PE)
- ・ ファイナルマニファクチャリング(FM)
- ・ 生産性設計(DM)

ISSM2008 のキーワード

- ・ NGF(Next Generation Factory)
- ・ 新ビジネス・モデルへの対応
- ・ 生産性の更なる向上
- ・ AEC/APC
- ・ 先端リソグラフィ技術の生産技術課題
- ・ 特定用途向け半導体用製造技術
- ・ 半導体製造における環境・安全対策
- ・ ナノレベルのコンタミ・コントロール

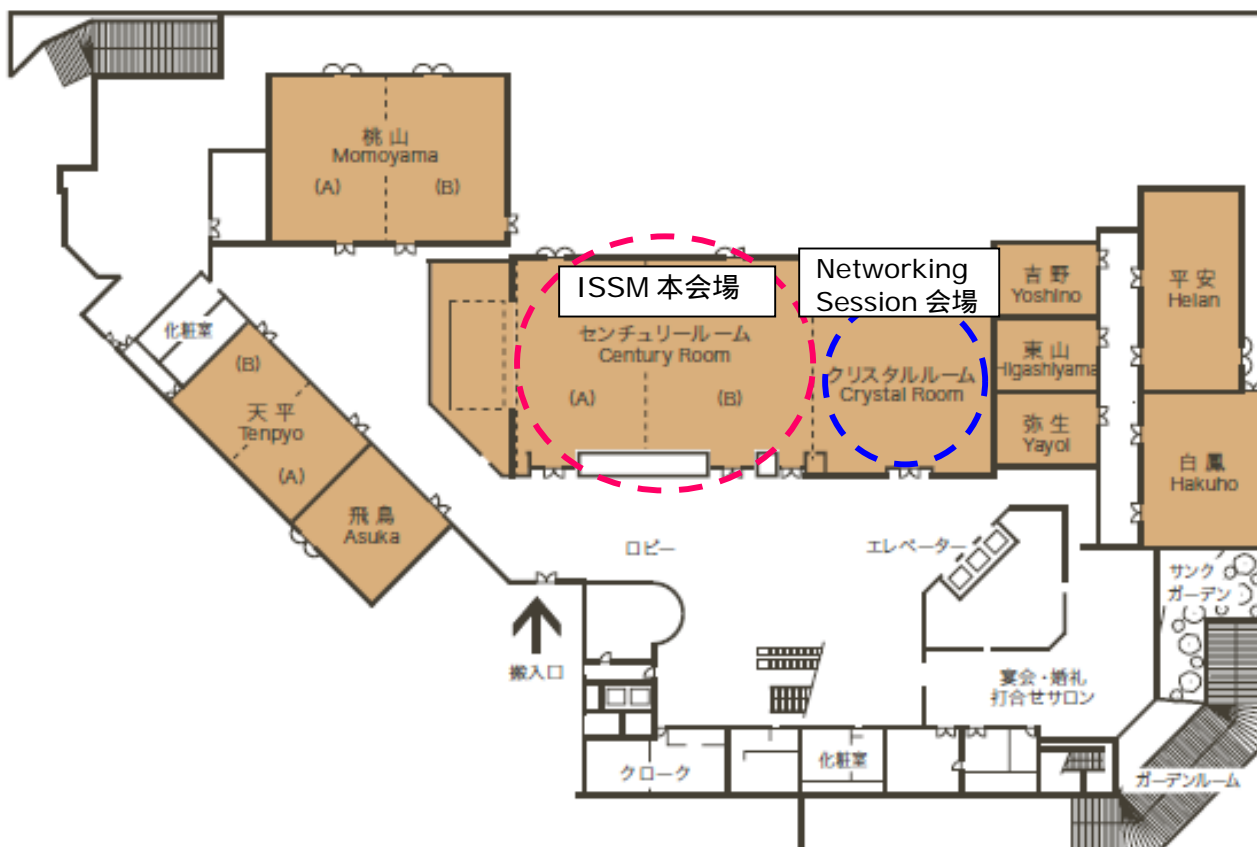


ISSM2008 全体スケジュール

*プログラムは変更する場合があります

		ISSM2008							
		Monday, October 27			Tuesday, October 28		Wednesday, October 29		
Time		Room A	Room B	Room C	Room A	Room B	Room A	Room B	
A M					Keynote 9:00-9:50		Introduction for ISSM2009 Invited 9:10-9:50		
		9:30-12:00 Tutorial (AEC/APC)	9:30-12:00 Tutorial (ESH)	Networking set-up	Keynote 9:50-10:40		Oral Session 4 papers 10:00-11:20	Oral Session 3 papers 10:00-11:00	
					Break			Author's interview & Break	
					Oral Session 4 papers 11:00-12:20	Oral Session 4 papers 11:00-12:20	Author's interview & Break	Oral Session 3 papers 11:20-12:20	
				Networking	Author's interview & Lunch		Author's interview & Lunch		
		Opening Remarks			Keynote 13:20-14:10		Oral Session 3 papers 13:20-14:20	Oral Session 2 papers 13:20-14:00	
		Keynote 13:20-14:10					Author's interview & Break		
		Keynote 14:10-15:00			PE-O-136	MC-O-19	Oral Session 3 papers 14:40-15:40	Oral Session 4 papers 14:20-15:40	
		Break 15:00-15:10							Author's interview & Break
	P M		Oral Session 3 papers 15:10-16:10	Oral Session 3 papers 15:10-16:10	Networking Session	Author's interview & Break		Oral Session 5 papers 16:00-17:40	Oral Session 5 papers 16:00-17:40
		Author's interview & Break				3min Speech for Interactive Poster Session 19 papers 16:40-18:00	3min Speech for Interactive Poster Session 18 papers 16:40-18:00	Author's interview	
		Oral Session 3 papers 16:30-17:30	Oral Session 3 papers 16:30-17:30			Poster Core session			
		Reception							

ハイアットリージェンシー東京 B1F フロアプラン





< ISSM2008 ネットワーキングセッション参加申込規約 >

1. ブースの転貸の禁止

ブース展示者は、自社分のブースを ISSM 事務局の承諾なしに転貸、売買、交換あるいは譲渡はできません。

2. 共同申込者

2 社以上の申込者が共同で参加する場合、1 社が代表して申し込み、共同参加する社名などを申し込み時に ISSM 事務局へ通知するものとします。

3. 展示物の搬入、設置および搬出

ブース展示者は、ISSM 事務局の定めるスケジュールに沿ってブース内の装飾、および展示物の搬入出を行わなければならないものとします。会期中、展示物の搬入・移動・搬出の必要が生じた場合は、ISSM 事務局の承認を得た後、作業を行うものとします。

4. ブースの使用

宣伝・営業活動はすべて割り当てブースの中に限られるものとします。

ブース展示者は、宣伝活動のためにブース近辺の通路が混雑することのないよう責任を持つものとします。

展示物などいかなるものも、割り当てられた床の範囲を越えてはならないものとします。

ISSM 事務局は、その音、操作方法、材料またはその他の理由から問題があると思われる装飾物・展示物、ネットワーキングセッションの目的に沿わない展示物を禁止又は撤去する権限を有するものとします。この権限は、人・物・行為・印刷物等、ISSM 事務局が問題があると考えた性質のすべてに及ぶものとします。

上記の制限または撤去が行われた場合、ISSM はブース申込者に対しいかなる返金、またはその他の関連費用負担の責を負わないものとします。

5. 展示物の管理と免責

ISSM は、ネットワーキングセッション会場の管理・保全について事故防止に最善の注意をはらいますが、あらゆる原因から生ずる各展示物の損失または損害についてその責任を負いません。

6. 損害賠償

ブース展示者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた、会場設備またはネットワーキングセッションの建造物もしくは人身等に対する一切の損失についての責任を負うものとします。

7. ネットワーキングセッションの中止

ISSM は、ネットワーキングセッションが開催される土地建物が入場に不相当となった場合、または不当な不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期を変更、もしくは開催を中止することができます。ISSM はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他展示者に生じた不利益な事態については責任を負わないものとします。

8. 参加料支払い方法

展示者は ISSM 事務局が発行する請求書に基づき、請求書記載の期日までに参加料を支払いものとします。支払いは指定の銀行口座のみとなります。約束手形、小切手等の取り扱いはしません。

9. 解約について

やむなく取り消しをされる場合には文書にてご連絡下さい。この場合、下記のキャンセル料をお支払いいただきます。

申込書確定通知後～2008年8月29日まで	ブース料の50%
2008年8月30日以降	ブース料の100%

10. 規約の遵守

ブース申込者は、ISSM が定める一連の規約を遵守することに同意するものとします。

11. 規約の変更と追加

ブース申込者は、この規約に定められていない事項、またはこの規約の条項について疑義が生じた場合は、ISSM 事務局の決定に従うものとします。

会場

ハイアットリージェンシー東京

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 2-7-2



徒歩での経路

- ・新宿駅西口より徒歩約 9 分
- ・地下鉄大江戸線都庁前駅 A7 出口に直結
- ・地下鉄丸ノ内線西新宿駅より徒歩約 4 分

お車での経路

- ・首都高速新宿出入口より約 5 分
- ・羽田空港より約 70 分
- ・新東京国際空港(成田)より約 120 分
- 無料送迎シャトルバス
- ・新宿駅西口小田急ハルレク前よりホテルまで、シャトルバス(無料送迎)が 20 分間隔で運行しております

成田エクスプレス利用で新宿まで約 70 分
東京シティエアーターミナルまでお車で約 25 分

申込み・問い合わせ先

ISSM日本事務局
株式会社セミコンダクタポータル
〒107-0052 東京都港区赤坂 2-17-22 赤坂ツインタワービル東館 17F
TEL:03-3560-3565 FAX:03-3560-3566
E-mail: issm_2008@semiconportal.com